

深圳市英唐智能控制股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参会单位及个人	中泰证券、广东西域投资、吉富创投、广东展富基金、厦门丹金恒信私募、凯石基金、华夏基金、广发基金、宏泰基金、关海果
时间	2025年12月4日
地点	线上会议
接待人员姓名	英唐智控董事长：胡庆周先生 英唐智控董事会秘书：李昊先生 光隆集成实控人：彭晖先生 光隆集成总经理：陈春明先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、基本情况介绍</p> <p>1、公司董事长胡庆周先生为投资者介绍了英唐智控的发展历程及发展现状，英唐智控深耕电子元器件分销，构建全球多区域网络，覆盖主芯片、存储、射频、显示驱动、功率/模拟器件、MEMS传感器及被动器件等全品类，积累了丰富的客户资源。自研芯片聚焦MEMS微振镜与车载显示芯片，通过加大研发投入、引进高端人才实现技术突破。公司已在多家头部屏厂成功导入车载显示芯片业务，首款车规级TDDI/DDIC的量产落地，多款改进型产品也在按计划推进流片、试产中。</p> <p>近期筹备并购桂林光隆集成与上海奥简微电子，旨在强化光通信芯片、模拟集成电路领域布局，与现有分销及自研业务形成协同效应，借助生成式AI、大模型训练及云计算的爆发式发展，OCS市场有望迎来更大的发展机遇，明确未来将构建以光、电、算技术闭环为核心的芯片设计制造企业，加速构建半导体全产业链能力。</p>

2、桂林光隆集成科技有限公司（以下简称“光隆集成”）实控人彭晖先生介绍了光隆集成的基本业务情况，团队背景为桂林国家级科研院所。光隆集成始终专注于光开关相关技术研发，在机械式、MEMS微机械式、磁光式、电光式及波导式等多种控制方式上均有长期布局。

彭晖先生详细解析了OCS量产所需的核心能力：首先是FAU（光纤阵列单元）组件的加工精度要求极高，达到微米级，传统机械加工无法满足，必须依托半导体制造平台；其次是半导体封装能力，涉及pitch间隔控制、漏气率、贴片精度等指标；第三是精密装配能力，例如32×32 OCS包含近万个逻辑态，传统人工装配成本高昂，而光隆集成已实现高精度自动贴合与自动化测试，这些能力的融合使得OCS批量化、可靠性与成本控制成为可能。

光隆集成在光芯片领域拥有全制程技术能力，基于MEMS技术的OCS(光路交换机)系统与英唐智控在MEMS微振镜领域形成技术共创。

二、提问交流环节

1. 请介绍一下光隆集成与客户有哪些？终端应用的场景有哪些？

光隆集成彭晖答：光隆集成专注于光开关相关技术研发，在机械式、MEMS微机械式、磁光式、电光式及波导式等多种控制方式上均有长期布局，光隆集成产品客户覆盖海内外市场，包括电信运营商、光模块厂商等。主要涵盖以下几个应用场景：一是算力与网络协同，服务于GPU与AI芯片的数据中心互联；二是电信运营商网络智能化管理，应对复杂光纤布线带来的安全风险，实现智能光网监控；三是光模块测试领域，头部厂商采购OCS作为模拟调度设备，用于验证高端光模块的大规模量产适配性。

2. 光隆集成的OCS技术路线背景？

光隆集成实控人彭晖回答：公司核心团队来自桂林的国家级科研院所，光隆集成始终专注于光开关相关技术研发，在机械式、MEMS微机械式、磁光式、电光式及波导式等多种控制方式上均有长期布局。光隆集成在光芯片领域拥有全制程技术能力，基于MEMS技术的OCS系统与英唐智控在MEMS微振镜领域形成技术共创。

3. 结合本次交易的进展及标的公司发展形势，公司如何展望本次合作对未来业绩增长的具体贡献？

英唐智控李昊答：光隆集成专注于光开关相关技术研发，OCS作为通信领

	域的关键技术之一，随着5G、数据中心等高速网络基础设施的建设和升级，国内外市场对其需求均呈现出增长趋势，未来发展前景广阔。目前，公司及有关各方正在积极推进本次交易，待审计、评估工作完成后，双方确定具体合作方案，公司将在草案中披露有关财务数据及业绩情况。
风险提示	公司发行股份及支付现金购买资产事项涉及向深交所、中国证监会等相关部门的申请审核注册工作，上述工作能否如期顺利完成可能对本次交易的时间进度产生重大影响。除此之外，本次交易存在被暂停、中止或取消的风险。公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单	
日期	2025年12月4日